

b. W 2214-02

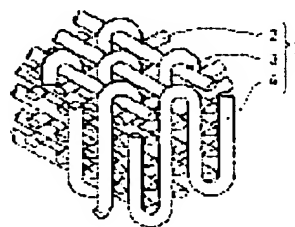
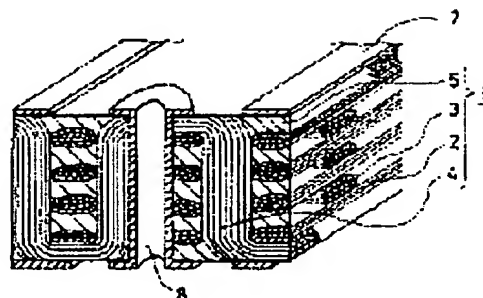
PRINTED WIRING BOARD**Publication number:** JP4023386**Publication date:** 1992-01-27**Inventor:** FUTAKUCHI MICHIO; SUGANO TOSHIYUKI; HATTA HIROSHI; SUZUKI MORIHIDE; HIROSHIMA NOBORU**Applicant:** MITSUBISHI ELECTRIC CORP**Classification:****- international:** **D03D15/12; D03D25/00; H05K1/03; D03D15/12; D03D25/00; H05K1/03; (IPC1-7): D03D15/12; D03D25/00; H05K1/03****- european:****Application number:** JP19900123659 19900514**Priority number(s):** JP19900123659 19900514

Report a data error here

Abstract of JP4023386

PURPOSE: To reduce the thermal expansion coefficient of a printed wiring board in the thickness direction and to reduce the generation of various defects due to the thermal expansion of the board in the thickness direction, such as the disconnection of a through-hole plating and the like under a high-temperature environment, by a method wherein a fiber reinforced plastic made of a three-dimensional structure fabric is used for the insulating layer of the printed wiring board.

CONSTITUTION: An insulating resin 5 is impregnated in a three-dimensional structure fabric 9 and is hardened to form the fabric 9 as an insulating layer 6 and when this layer 6 is a double-sided plate, circuit conductors 7 are respectively formed on both sides of the layer 6 and when the layer 6 is a multilayer plate, a circuit conductor 7 is formed also in the middle of the layer 6. When the resin 5 inclines to expand thermally under a high-temperature environment, fibers 2, 3 and 4 in the longitudinal, lateral and thickness directions of the fabric 9 of a thermal expansion coefficient smaller than that of the resin 5 work so as to inhibit the thermal expansion of the layer 6. Thereby, the thermal expansion coefficient of a printed wiring board can be reduced also in the thickness direction in addition to conventional thermal expansion coefficients in the longitudinal and lateral directions.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許出願公告番号

特公平7-36465

(24) (44) 公告日 平成7年(1995)4月19日

(51) Int. Cl. ⁶

識別記号

F I

H05K 1/03

G 7011-4E

D03D 15/12

A 7199-3B

25/00

7199-3B

請求項の数1 (全4頁)

(21) 出願番号 特願平2-123659
(22) 出願日 平成2年(1990)5月14日
(65) 公開番号 特開平4-23386
(43) 公開日 平成4年(1992)1月27日

(71) 出願人 999999999
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内2丁目2番3号
(72) 発明者 二口 通男
神奈川県相模原市宮下1丁目1番57号 三
菱電機株式会社相模製作所内
(72) 発明者 菅野 俊行
兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三
菱電機株式会社材料研究所内
(72) 発明者 八田 博志
兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三
菱電機株式会社材料研究所内
(74) 代理人 弁理士 高田 守 (外1名)

審査官 平山 美千恵

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プリント配線板

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 繊維強化プラスチックを絶縁層として用いたプリント配線板であって、該絶縁層に三次元構造織物の繊維強化プラスチックを用いたことを特徴とするプリント配線板。

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】

この発明はプリント配線板、特に絶縁層に三次元構造織物の繊維強化プラスチックを用いたプリント配線板に関するものである。

【従来の技術】

従来、この種のプリント配線板として第3図ないし第5図に示すものが知られている。第3図は従来のプリント配線板を示す断面図、第4図は同二次元構造である平織の繊維布を示す断面図、第5図は同平面図である。

2

図において、1は二次元構造である平織繊維布で、この平織繊維布1はたて方向繊維2とよこ方向繊維3とからなっており、6はこの平織繊維布1を複数層重ね合わせ、絶縁樹脂5により固めた絶縁層、7はこの絶縁層6の両側に形成した回路導体であり、多層板の場合には、中間にもこの回路導体7を形成してある。8は絶縁層6内に貫装したスルーホールメッキである。

次に動作について説明する。

第3図に示すように構成したプリント配線板の絶縁樹脂5は、高温環境下において熱膨張しようとする。そのとき、絶縁樹脂5よりも熱膨張係数が小さい平織繊維布のたて方向繊維2とよこ方向繊維3が絶縁層6の熱膨張を拘束するため、絶縁層6のたて、よこ方向の熱膨張を抑制できる。しかし、厚み方向については、絶縁樹脂5の熱膨張を拘束する繊維がないため、厚み方向熱膨張係数

10

は、絶縁樹脂 5 単体のそれとほぼ同程度の値となっていた。

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、従来のプリント配線板は、以上のように構成されているので、厚み方向については、絶縁樹脂の熱膨張を拘束する繊維がないため、高温環境下において、厚み方向の熱膨張が過大となるため、スルーホールメッキが切れ、断線してしまうことがあるなどの問題があった。

この発明は、このような問題を解消するためになされたもので、絶縁層に三次元構造織物の繊維強化プラスチックを用いたことにより、厚み方向における熱膨張係数の低減をはかり、高温環境下においても、熱膨張が過大となることを抑制し、スルーホールメッキ切れなどの欠陥の発生を防止できるプリント配線板を提供することを目的としている。

〔課題を解決するための手段〕

このため、この発明のプリント配線板は、繊維強化プラスチックを絶縁層として用いたプリント配線板であって、該絶縁層に三次元構造織物の繊維強化プラスチックを用いたものである。

〔作用〕

この発明のプリント配線板においては、絶縁層に用いた三次元構造織物の厚み方向繊維が、高温環境下における絶縁層の厚み方向の熱膨張を抑制することにより、熱膨張が過大とならず、スルーホールメッキ切れなどの発生を防止できるように働く。

〔実施例〕

以下に、この発明の一実施例のプリント配線板について、図に基いて説明する。第 1 図はこの発明の一実施例に係るプリント配線板を示す一部裁断した斜視図、第 2 図は同三次元構造織物を模式的に示した斜視図である。前記従来例と同一部分または相当部分は同一符号を用い、説明の重複をさける。

図において、9 は三次元構造織物であり、この三次元構造織物 9 は、たて方向繊維 2、よこ方向繊維 3、厚み方向繊維 4 とからなり、三次元構造となっている。

そして、この三次元構造織物 9 に、絶縁樹脂 5 を含浸硬化させることにより、絶縁層 6 とし、この絶縁層 6 が両面板であるときは、その両側に回路導体 7 を形成してある。前記絶縁層 6 が多層板であるときは、その中間にも回路導体 7 を形成するようになっている。

次に、動作について説明する。第 1 図に示した絶縁樹脂 5 は、高温環境下において熱膨張しようとする。そのとき、絶縁樹脂 5 よりも熱膨張係数の小さな三次元構造織物のたて、よこ、厚み方向の繊維 2、3、4 が絶縁層 6 の熱膨張を抑制するように働くため、従来のたて、よこに加え、厚み方向においても、熱膨張係数を低減できる。

この一実施例及び従来例の構成時の常温での厚み方向熱膨張係数を測定した例を表 1 に示す。

	絶縁層の構成 (繊維／樹脂)	厚み方向熱膨 張係数(℃ ⁻¹)
従来例 1	平織ガラス／エポキシ	64.4×10 ⁻⁶
従来例 2	平織ガラス／ポリイミド	54.0×10 ⁻⁶
実施例 1	三次元ガラス／エポキシ	22.3×10 ⁻⁶
実施例 2	三次元ガラス／ポリイミ ド	15.8×10 ⁻⁶

この表 1 に示した測定結果から判るように、プリント配線板の絶縁層 6 に、三次元織物の繊維強化プラスチックである三次元ガラス／エポキシを用いたこの発明の一実施例による実施例 1 の厚み方向の熱膨張係数を、絶縁層 6 に平織ガラス／エポキシを用いた従来例 1 の厚み方向熱膨張係数の約 3 分の 1 に低減でき、また、絶縁層 6 に、三次元ガラス／ポリイミドを用いたこの発明による実施例 2 の厚み方向の熱膨張係数を、平織ガラス／ポリイミドを用いた従来例 2 の熱膨張係数の約 3 分の 1 に低減できた。

この発明の一実施例のプリント配線板によれば、プリント配線板 1 の絶縁層 6 に、三次元構造織物の繊維強化プラスチックである三次元ガラス／エポキシまたは三次元ガラス／ポリイミドを用いたことにより、厚み方向の熱膨張係数を低減できるため、高温環境下でもスルーホールメッキ切れなどの厚み方向の熱膨張によるいろいろな欠陥の発生が防止されるプリント配線板を提供できるという効果を奏する。

〔他の実施例〕

前記この発明の一実施例では、両面板の場合について示したが、多層板の場合においても、同様の効果を奏することはいうまでもない。

〔発明の効果〕

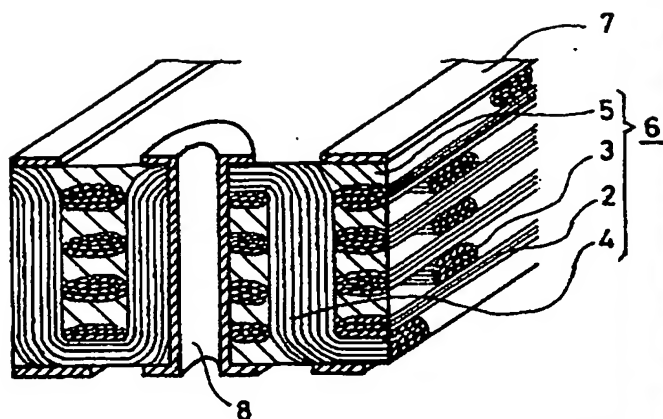
以上に説明してきたように、この発明のプリント配線板によれば、プリント配線板の絶縁層に、三次元構造織物の繊維強化プラスチックを用いたことにより、厚み方向の熱膨張係数を低減できるので、高温環境下でのスルーホールメッキ切れなどの厚み方向の熱膨張による種々の欠陥の発生を低減できる効果がある。

〔図面の簡単な説明〕

第 1 図はこの発明の一実施例に係るプリント配線板を示す一部裁断した斜視図、第 2 図は同三次元構造織物を模式的に示した斜視図、第 3 図は従来のプリント配線板を示す断面図、第 4 図は同プリント配線板の絶縁層に用いる平織繊維布を示す断面図、第 5 図は同平面図である。図中、2 はたて方向繊維、3 はよこ方向繊維、4 は厚み方向の繊維、5 は絶縁樹脂、6 は絶縁層、7 は回路導体、8 はスルーホールメッキ、9 は三次元構造織物である。

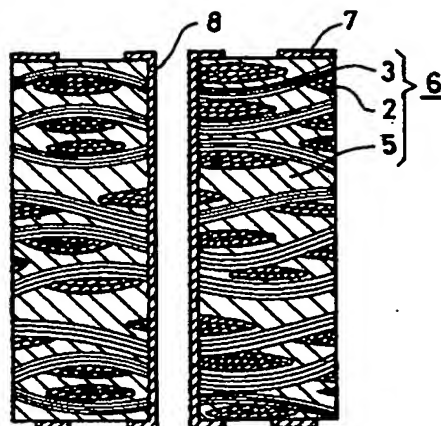
なお、図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。

【第 1 図】



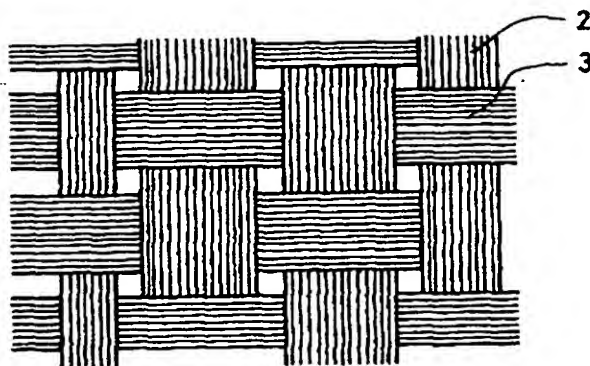
- 2 : たて方向織紐
3 : よこ方向織紐
4 : 厚み方向織紐
5 : 絶縁樹脂
6 : 絶縁層
7 : 導体層
8 : スルーホールメッキ

【第 3 図】

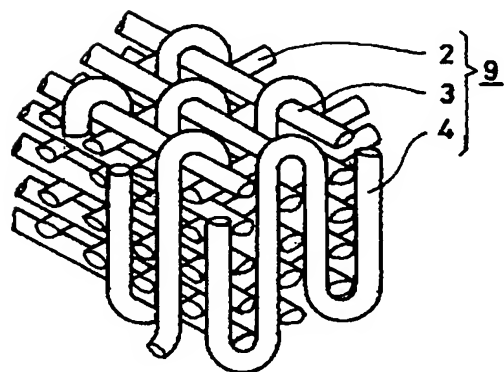


- 2 : たて方向織紐
3 : よこ方向織紐
5 : 絶縁樹脂
6 : 絶縁層
7 : 導体層
8 : スルーホールメッキ

【第 5 図】

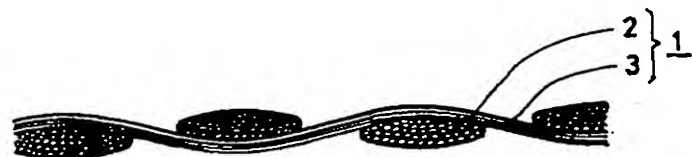


【第 2 図】



- 2 : たて方向織紐
3 : よこ方向織紐
4 : 厚み方向織紐
9 : 三次元構造織物

【第 4 図】



- 1 : 平織織布
2 : たて方向織紐
3 : よこ方向織紐

BEST AVAILABLE COPY

フロントページの続き

(72)発明者 鈴木 守英

神奈川県相模原市宮下 1 丁目 1 番 57 号 三
菱電機エンジニアリング株式会社東京事業
所相模支所内

(72)発明者 広嶋 登

神奈川県相模原市宮下 1 丁目 1 番 57 号 三
菱電機エンジニアリング株式会社東京事業
所相模支所内

(56)参考文献 特開 昭63-274510 (J P , A)